



镀覆技术 Plating Technology

广州大学 广州市二轻工业科学技术研究所 主办

通用五金电镀

装饰性涂层

铜, 镍, 铬-应用于汽车行业的无与伦比的电镀方案



安美特的多层镍工艺和镀铬工艺是经多年来应用于汽车行业的功能型和装饰性电镀经验所得的成果。

将半光镍和光亮镍工艺与安美特的微孔镍和高质量的镀铬技术相结合, 能满足装饰性电镀和防腐蚀的需求。



工艺类型	产品
铜	酸铜 Cupracid® 和 CuFlex® 系列
半光镍	安麦克系列
高硫镍	高硫镍
光亮镍	光亮镍 2002, Supreme Plus, 光亮镍 ZD-220
珍珠镍	珍珠镍
微孔镍	液体镍封 800, MPS 300 镍封颗粒
微裂纹镍	高应力镍
三价铬	三价铬 TriChrome® 系列
六价铬	CR 843

安美特(中国)化学有限公司

香港-电话: (852) 2722 0108 传真: (852) 2721 3540
广州-电话: (86) 20-8297 5160 传真: (86) 20-8297 5170
上海-电话: (86) 21-6921 0608 传真: (86) 21-6921 0202

香港 • 广州 • 上海 • 南京 • 天津 • 重庆 • 温州 • 东莞 • 中山
青岛 • 成都 • 惠州 • 宁波 • 义乌 • 厦门 • 武汉 • 肇庆 • 长春

www.atotech.com



目 次 CONTENTS

研究报告 Research Report

- 1075 珍珠镍电镀添加剂、工艺条件及镀层性能研究 何湘柱, 曹香雄, 谢金平, 范小玲
Study on additives and process conditions of pearl nickel plating and properties of coating
HE Xiang-zhu, CAO Xiang-xiong, XIE Jin-ping, FAN Xiao-ling
- 1082 整平剂对酸性电镀硬铜的影响 肖宁, 邓志江, 滕艳娜, 潘金杰, 张宜初, 雍兴跃
Effects of different leveling agents on hard copper electroplating in acidic sulfate electrolyte
XIAO Ning, DENG Zhi-jiang, TENG Yan-na, PAN Jin-jie, ZHANG Yi-chu, YONG Xing-yue
- 1088 自动脉冲刷镀工艺参数对镍-氧化铝复合镀层残余应力的影响 海源, 张松, 李剑峰, 满佳
Effects of process parameters of automatic pulse brush plating on residual stress of nickel-alumina composite coating
HAI Yuan, ZHANG Song, LI Jian-feng, MAN Jia
- 1093 木材纤维素微纳米纤丝化学镀银工艺优化 王宇, 黄金田
Optimization of electroless silver plating process on surface of wood's micro-nano cellulose fibrils
WANG Yu, HUANG Jin-tian
- 1100 铜表面化学镀钯工艺研究 张甜甜, 赵亮亮, 万传云, 何云庆, 徐彬
Study on process of electroless palladium plating on copper
ZHANG Tian-tian, ZHAO Liang-liang, WAN Chuan-yun, HE Yun-qing, XU Bin
- 1105 基于稳健设计的ENEPIG印制板化学镀钯工艺研究 于金伟
Study on electroless palladium plating for ENEPIG printed circuit board based on robust design YU Jin-wei
- 1112 电感耦合等离子体发射光谱法测定钕铁硼镀镍液中铁和铜 邹龙, 刘荣丽, 易师, 徐拓
Determination of iron and copper in nickel plating bath for neodymium-iron-boron by inductively coupled plasma optical emission spectrometry
ZOU Long, LIU Rong-li, YI Shi, XU Tuo

工艺开发 Process Development

- 1115 High brightness silver plating for leadframe 引线框架上的高光亮度银电镀 Ray Ting, Flora He, Derek Yip, Dennis Chan
丁辉龙, 何蕊, 叶家明, 陈喆垚
- 1123 被动元件甲基磺酸盐体系电镀纯锡 任秀斌, 裘宇, 吴水, 肖定军, 安茂忠
Tin plating in methanesulfonate bath for passive component
REN Xiu-bin, QIU Yu, WU Shui, XIAO Ding-jun, AN Mao-zhong

综述 Review

- 1128 环保型镀锡板钝化研究进展 罗龚, 王浩浩, 王紫玉, 袁国辉, 黎德育, 李宁
Research progress of environment-friendly passivation of tinplate
LUO Gong, WANG Ming-hao, WANG Zi-yu, YUAN Guo-hui, LI De-yu, LI Ning

最新专利 Latest Patents

- 1133 一种表面电沉积铂纳米花的电极及其制备方法和应用, 一种用于提高电镀锌钢板表面明度的磷化剂及制备方法, 等25则。

信息 Information

- 1087 《电镀基础讲座》推荐
1099 书讯
1111 梦得杯——2014年度优秀论文评选第一阶段公告
1137 行业会讯
1138 广告索引



十年专注 绿色环保

核心产品：TH-10电解挂具剥离粉

国内首创粉末型产品，行业领头羊，世界一流品质。

退镀系列产品：TH-9铁件电解剥离粉、TC-18电解铜上剥镍剂



前处理系列产品：

DC-338通用阳极电解除油粉
CL-320高效除油除蜡粉
CL-380高效无磷除油除蜡粉



深圳总公司
深圳市华辉科技有限公司
地址：深圳市宝安区龙华街道宝华路173号
电话：0755-27740218
传真：0755-27746969
邮箱：hh@huahigh.com
网址：http://www.huahigh.com
联系人：严先生 手机：13632983158



厦门分公司
厦门珀芬特金属表面技术有限公司
厦门地址：厦门市海沧区新阳街道霞美路2号
电话：0592-6511238
传真：0592-6511691
邮箱：pofente@163.com
联系人：蔡先生 手机：13959793590

